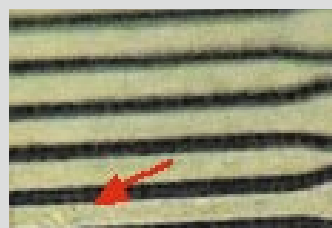


【原因、判断要点、发生工序】镀金完成后，在镀金插脚的表面堆积或附着的杂物加重负荷，或者粘性杂物固化所引起的（镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a foreign object on the gold edge board contact(s) which is piled up or attached and fixed by pressure, or adhered and hardened after gold plating (After gold plating)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

4-2-1-10 金めっき端子打痕／镀金插脚的压痕 / Dent on gold plated edge board contact

【特徴】金めっき端子表面に打痕が認められる状態の欠陥

【特征】镀金插脚表面有压痕的缺陷。

【Characteristics】The surface of a gold plated edge board contact is dented.

【原因・判断ポイント・発生工程】プレス打ち抜き外形加工などの際金めっき端子上に異物が介在したため出来たもの（打ち抜きプレス加工工程）

【原因、判断要点、发生工序】冲切外形时镀金插脚上夹杂杂物所引起的（冲切工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the presence of a foreign object on a gold plated edge board contact when outlining by board punching (Punching process)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

4-2-2 めっき条件管理不良起因（金めっき欠陥）／电镀条件的管理不善（镀金层缺陷）／ Caused by improper plating condition(gold plating defects)

4-2-2-1 金めっき降り／镀金层的下沉 / Gold particle scattered on solder resist

【特徴】微細な金粒子がソルダレジスト表面に多数附着している状態の欠陥

【特征】在阻焊剂表面附着许多细微的金粒子的缺陷。

【Characteristics】Many fine gold particles are attached to the surface of solder resist.



【コメント】
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50